

# 硅整流桥堆

**E** R

## **R6S08-H**

## 产品概述

R6S08-H 是硅整流桥 堆,该产品采用平面工艺, 高温下漏电电流极小,可靠 性较高。

## 产品特点

- ●超低反向漏电电流
- ●封装厚度薄
- ●ESD 击穿电压高
- ●无铅封装
- ●耐焊接温度高

## 应用

- LED 整流电路
- 节能灯
- 中小功率电源

## 特征参数

符 号	额定值	单 位
$V_R$	600	V
$I_{\mathrm{F}}$	0.8	A

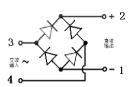
## 封装 SOP4



## 存储条件和焊接温度

存放有效期	存放条件	极限耐焊接热
1 /5	环境温度-10℃~40℃	265°C
1年	相对湿度 <85%	265℃

## 内部结构图



## 极限值 (Per Diode)

除非另有规定, T₂= 25℃

参数名称	符号	额定值	单位
重复峰值反向电压	$V_{RRM}$	600	V
直流阻断电压	V <sub>DC</sub>	600	V
平均正向整流电流	I <sub>F(AV)</sub>	0.8	A
持续正向整流峰值电流	$I_{max}$	3	A
峰值正向浪涌电流	$I_{FSM}$	12	A
结到管壳的热阻最大值	$R_{\Theta JA}$	200	°C/W
贮存温度	T <sub>stg</sub>	-55~150	$^{\circ}$

## **R6S08-H**



## 电参数 (Per Diode)

参数名称	符号	油 净 友 4		单位			
多	何 写	测试条件	最小	典型	最大	毕业.	
反向电压	$V_R$	I <sub>R</sub> =1mA	600			V	
反向电流	T	$V_R$ =600V, $T_a$ =25 °C			0.5	4	
<b>汉</b> 門电机	$\mathbf{I}_{\mathrm{R}}$	$V_R$ =600V, $T_a$ =125°C			2	μΑ	
正向压降	$V_{\mathrm{F}}$	I <sub>F</sub> =0.4 A			1.0	V	
113.74.741747 < 200	2 < 2 0 1						

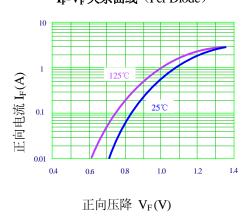
a: 脉冲测试 tp≤300 μ s, δ ≤2%

## 有害物质说明

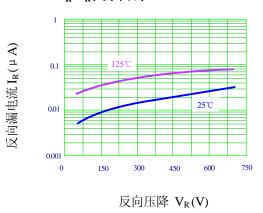
	有毒有害物质或元素									
					多溴	多溴二	六溴环	邻苯二	邻苯二	邻苯二
如此勾场					联苯	苯醚	十二烷	甲酸酯	甲	甲
部件名称					PBB	PBDE	HBCDD	DEHP	酸二丁	酸丁苄
(含量要求)	铅	汞	镉	六价铬					酯	酯
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)					DBP	BBP
	≤0.1%	≤0.1%	≤0.01%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%
引线框	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
塑封树脂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管 芯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内引线	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
焊料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
说明	说 明   ○:表示该元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的限量要求以下。									

## 特性曲线

**I<sub>F</sub>-V<sub>F</sub> 关系曲线**(Per Diode)



I<sub>R</sub>-V<sub>R</sub> 关系曲线(Per Diode)



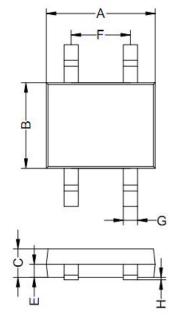


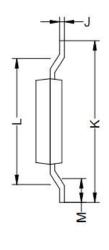
#### **R6S08-H**



#### 外形图 SOP4

(单位: mm)





项目	规范(mm)				
<b>坝</b> 月	MIN	MAX			
A	4.5	4.7			
В	3.6	3.8			
С	1.2TYP.	6.70			
Е	0.45	0.65			
F	2.6	2.8			
G	0.6	0.8			
Н	0.05	0.15			
J	0.2TYP.				
K	6.6	7.0			
L	5.1	5.5			
M	0.9	1.1			

## 包装说明

- 1) 产品的小包装,采用 5000 只/盘的塑料袋包装;
- 2) 产品的中包装,采用2盘/盒的中号纸盒包装;

#### 注意事项

- 1) 凡华润华晶出厂的产品,均符合相应规格书的电参数和外形尺寸要求;对于客户有特殊要求的产品,双方应签订相 关技术协议。
- 2) 建议器件在最大额定值的 80% 以下使用;在安装时,要注意减少机械应力的产生,防止由此引起的产品失效;避免靠近发热元件;焊接上锡时要注意控制温度和时间。
- 3) 本规格书由华润华晶公司制作,并不断更新,更新时不再专门通知。

#### 联络方式

#### 无锡华润华晶微电子有限公司

公司地址 中国江苏无锡市梁溪路 14 号

邮编: 214061 网址: <a href="http://www.crhj.com.cn">http://www.crhj.com.cn</a>

电话: 0510-8580 7228 传真: 0510-8580 0864

市场营销部 邮编: 214061 电话: 0510-8180 5277 / 8180 5336

E-mail: sales@hj.crmicro.com. 传真: 0510-8580 0360 / 8580 3016

应用服务 电话: 0510-8180 5243 传真: 0510-8180 5110